



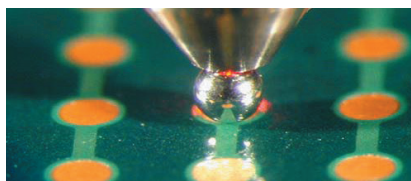
Полуавтоматическая установка монтажа шариков припоя SB²-M



SB²-M является самой компактной платформой в серии установок SB². При минимальной рабочей площади установка обладает достаточно большой рабочей зоной. Основными рабочими функциями SB²-M являются полуавтоматический монтаж и лазерное оплавление шариков припоя, ремонт. Эта модель может быть эффективно использована при прототипировании и проведении НИОКР.

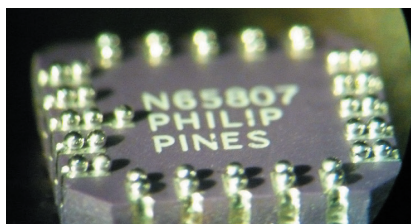
Основные возможности:

- Бесконтактный монтаж шариков припоя
- Материалы припоя – SnAgCu, SnAg, SnPb, AuSn, InSn, SnBi
- Бесфлюсовая пайка методом лазерного оплавления
- Диаметр шариков припоя от 100 до 760 мкм
- Функция ремонта (снятие шариков и реболлинг)



Возможные применения:

- Бампинг пластин или одиночных кристаллов
- Корпусирование на уровне пластин (Wafer Level CSP)
- Монтаж шариков припоя на корпуса BGA / CLCC, реболлинг
- Бесконтактная лазерная пайка компонентов на печатных платах
- Корпусирование MEMS и компонентов по технологии 3D
- Производство жестких дисков (HGA, HSA, Hook-Up, Spindle-motor)
- Сборка видеокамер, CMOS-датчиков
- Сборка изделий оптоэлектроники и микрооптических приборов
- Производство фильтров (SAW, BAW, F-BAR)



Параметры	SB ² -M
Габариты / Рабочая зона	752 x 700 x 1819 мм / 100 x 100 мм
Скорость и точность монтажа шариков	3–5 шар/сек; ± 15 мкм, 1 σ
Диаметр шариков	≥ 100 мкм
Рабочая станция	Стол для пластин
Автоматизация	Нет
Лазерная ручная центровка / Лазерная автоматическая центровка	Есть / Нет
Распознавание образов	Опционально (рабочая зона 50 x 100 мм)
2D / 3D пайка	Есть / Нет
Ремонт	Опция
Виды изделий	Части пластин, подложки, одиночные кристаллы, корпуса BGA и CSP

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

*Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники*